

证券代码：300223

证券简称：君正股份

公告编号：2026-060

## 北京君正集成电路股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

近期，为保证北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英属开曼群岛商矽成科技股份有限公司台湾分公司（以下简称“ISSI开曼台湾分公司”）的生产经营需要，公司全资子公司美商矽成积体电路股份有限公司（Integrated Silicon Solution, Inc., “ISSI”）向华虹半导体制造（无锡）有限公司出具了《保证函》，为ISSI开曼台湾分公司在华虹半导体制造（无锡）有限公司加工生产产品需支付的货款提供担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子公司的分公司提供担保，ISSI已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。

### 二、被担保人基本情况

英属开曼群岛商矽成科技股份有限公司台湾分公司

成立日期：2012年1月3日

注册地点：新北市汐止区新台五路1段106号7楼

经理人：刘伟平

主营业务：电子材料批发业、电子材料零售业

与本公司的关系：公司下属全资子公司的分公司

是否为失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

1、担保生效日期：2026年8月14日

2、担保期间：自ISSI签发给华虹半导体制造（无锡）有限公司起生效，直至ISSI开曼台湾分公司终止华虹半导体制造（无锡）有限公司的委托加工业务，且ISSI开曼台湾分公司履行完毕所有应支付给华虹半导体制造（无锡）有限公司的款项之日止。

3、保证范围：从生效日期起，ISSI承担所有延迟付款的款项的支付义务。

#### **四、累计及逾期对外担保的情况**

截止本公告披露日，公司及子公司未发生因未支付应付到期货款等而导致担保方支付费用的情形。

截止本公告披露日，公司子公司累计对子公司提供的实际担保发生金额为0元，公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、风险提示**

本次公司全资子公司ISSI向华虹半导体制造（无锡）有限公司所提供担保的公司为公司全资子公司的分公司，ISSI与该公司共同和单独承担采购订单项下对华虹半导体制造（无锡）有限公司的所有付款义务。截止本公告披露日，ISSI累计对子公司提供的实际担保发生金额为0元。敬请投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

保证函

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日